

证券简称：信维通信

证券代码：300136



深圳市信维通信股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年三月

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”或“公司”）拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次发行股票预计募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于“商业卫星通信器件及组件项目”、“射频器件及组件项目”和“芯片导热散热器件及组件项目”，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟用募集资金投入
1	商业卫星通信器件及组件项目	356,316.21	285,000.00
2	射频器件及组件项目	285,270.72	215,000.00
3	芯片导热散热器件及组件项目	116,941.91	100,000.00
合计		758,528.84	600,000.00

在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

二、本次募集资金投资项目情况

（一）本次募集资金投资项目的具体情况

1、商业卫星通信器件及组件项目

（1）项目概况

本项目实施主体为公司全资子公司信维通信（江苏）有限公司，建设地点位

于江苏省常州市金坛区金龙大道 369 号，总投资 356,316.21 万元，拟使用募集资金 285,000.00 万元，项目建设期 36 个月。本项目将利用现有厂房并进行改造，不涉及新增土地。

(2) 项目效益情况

经可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。项目实施后，能够为公司带来稳定的现金流入，提升整体盈利能力。

(3) 项目备案及环评情况

本项目已取得常州市金坛区发展和改革局出具的投资项目备案证，项目涉及的环评手续尚在办理过程中，公司将按照国家相关法律、法规要求及时、合规办理。

2、射频器件及组件项目

(1) 项目概况

本项目实施主体为公司全资子公司信维通信（江苏）有限公司，建设地点位于江苏省常州市金坛区金龙大道 369 号，总投资 285,270.72 万元，拟使用募集资金 215,000.00 万元，项目建设期 36 个月。本项目将利用现有厂房并进行改造，不涉及新增土地。

(2) 项目效益情况

经可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。项目实施后，能够为公司带来稳定的现金流入，提升整体盈利能力。

(3) 项目备案及环评情况

本项目已取得常州市金坛区发展和改革局出具的投资项目备案证，项目涉及的环评手续尚在办理过程中，公司将按照国家相关法律、法规要求及时、合规办理。

3、芯片导热散热器件及组件项目

(1) 项目概况

本项目实施主体为公司全资子公司信维通信（江苏）有限公司，建设地点位于江苏省常州市金坛区金龙大道 369 号，总投资 116,941.91 万元，拟使用募集资金 100,000.00 万元，项目建设期 36 个月。本项目将利用现有厂房并进行改造，不涉及新增土地。

(2) 项目效益情况

经可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。项目实施后，能够为公司带来稳定的现金流入，提升整体盈利能力。

(3) 项目备案及环评情况

本项目已取得常州市金坛区发展和改革局出具的投资项目备案证，项目涉及的环评手续尚在办理过程中，公司将按照国家相关法律、法规要求及时、合规办理。

(二) 本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

1、项目实施的必要性

(1) 把握战略机遇，巩固技术领先地位

当前，信息技术领域各类前沿技术持续发展与交叉融合，为高端电子元器件行业带来了相应的市场空间与发展机会。公司所关注的商业卫星通信、射频器件及芯片导热散热三个方向，是支持相关产业发展的基础环节，市场需求呈现持续增长态势。

在此背景下，公司作为相关领域的参与企业，有必要通过本次募投项目缓解产能约束，将技术积累转化为规模生产能力。目前，现有产能已逐渐难以完全满足下游客户订单的增长，成为公司进一步拓展市场、维持竞争力的现实约束。

因此，本项目的建设是公司顺应产业发展趋势、将技术优势转化为市场优势的战略举措，有助于巩固在传统优势领域的领先地位，为长期高质量发展注入持续动力。

(2) 深化技术产业化，构建综合竞争优势

公司的核心竞争力源于持续的研发投入和“材料—零件—模组”的一站式技术创新能力。本项目是公司推动技术成果产业化的关键载体。通过对先进材料、技术、工艺等工程能力的扩充与升级，实现高附加值产品的批量生产，优化营收结构，提升高端产品的收入占比，增强整体盈利能力。

同时，规模化生产将明显提升公司的生产效率。一方面，能够摊薄单位生产成本，提升产品性价比，在国产化替代浪潮中增强市场竞争力；另一方面，有利于公司为客户提供更全面、定制化的解决方案，从而深化客户合作，构建坚实的技术与客户壁垒，强化在产业链中的核心地位。

2、项目实施的可行性

(1) 政策多维赋能，产业方向明确，营造良好发展环境

国家及地方层面围绕新一代信息技术、商业航天、智能汽车、高端元器件等领域密集出台了一系列产业政策，为本项目的实施提供了明确的战略指引和有利的市场环境。宏观层面，《数字中国建设整体布局规划》等顶层设计强调要加快建设新型基础设施，推动产业智能化、高端化升级，与公司重点发展的卫星通信、射频及散热技术高度契合。产业专项层面，工信部等部门针对卫星通信、5G/6G、智能网联汽车等出台了具体的发展规划和指导意见，明确提出要突破关键核心技术，完善产业链供应链，为本项目产品提供了清晰的应用场景和市场入口。多层次的政策支持体系，从技术研发、产能建设到市场应用形成了全方位赋能，确保了项目方向与国家战略同频共振，为成功实施奠定了坚实的政策基础。

(2) 前沿技术布局，工艺经验成熟，保障量产落地

A. 商业卫星通信器件及组件项目

公司凭借多年在射频通信领域的深耕，已构建了成熟的质量管控体系和核心技术优势。在阵列天线及模组领域，通过多种材料和技术的创新集成设计，实现了产品宽频化与轻量化；在高频高速连接器领域，通过定制化设计与多层级防水密封技术，产品可在宽温域及复杂环境下稳定工作。公司成熟的核心技术方案为项目大规模量产提供了可靠的工艺和技术保障。

B. 射频器件及组件项目

公司在射频技术领域已形成多维度、领先的技术储备。LCP 天线方面，公司拥有自主研发的 LCP 薄膜及柔性覆铜板规模化量产能力，采用合金浆料真空塞孔、多层高温一次压合的独有先进工艺，性能稳定；透明天线方面，公司通过 UltraMesh 工艺在透明基材上构建微米级金属网格，产品光学与电学性能优异；毫米波雷达天线组件方面，公司掌握缝隙波导天线等核心器件的生产工艺，并拥有精密模具注塑及全流程自动化组装测试核心技术。公司已构建全流程标准化工艺闭环，核心工序自动化，并通过了消费级、工业级、汽车级多场景质量体系认证，技术成熟度与产品稳定性已获市场验证，具备大规模量产的条件。

C. 芯片导热散热器件及组件项目

公司在芯片封装散热方面有一站式解决方案，聚焦高导热热界面 TIM1 材料与芯片封装散热片两大核心产品。在 TIM1 材料方面，公司通过自研掌握了基于液态金属和高分子材料的先进配方技术，该材料具备高热导率、优异的界面兼容性与极端工况适应性，能够精准匹配先进封装及算力芯片等高端应用场景的散热需求。在芯片封装散热片方面，公司掌握了核心的精密微加工与半导体表面处理技术，在保障性能与品质前提下兼具产能与成本优势，满足多场景下的可靠性要求。经过数年的研发与生产的积累，公司已建立起完善的工艺参数数据库，生产管理体系与供应链渠道完备，为后续快速量产与品质一致性提供了坚实保障。

(3) 市场需求旺盛，客户资源优质，确保产能有效消化

在高度关注且充分理解客户真正需求的基础上，公司已经搭建了优质的全球大客户平台，并持续与客户保持良好的合作关系，把客户满意落到实处，凭借稳定的品质、及时的交付、有竞争力的产品，获得了客户的高度认可，凭借着基础材料、基础技术的持续投入，公司技术能力受到客户的重视，公司定期与全球大客户展开技术交流，增加了大客户的黏性与新技术的洞察力。

在商业卫星地面终端领域，公司已经是北美商业卫星客户的长期供应商，产品已获批量采用；在射频器件和组件领域，公司客户覆盖全球多家知名科技企业及主流主机厂，与核心客户建立了深度合作关系；在芯片导热散热器件领域，公司是中国内地能为北美大客户批量供应芯片导热器件的企业，产品技术创新、性能指标及可靠性获市场充分认可。

(4) 完善的管理制度和人才储备为募投项目实施保驾护航

公司管理层根据业务发展及客户的需求对组织架构进行优化,完善内部管理制度和流程,提升决策效率、生产组织、交付质量,强化多任务处理能力、综合工程实现能力、柔性制造能力以及供应链管理的能力,逐渐搭建了平台型大事业部制组织架构,目前已与客户形成高效且全面的对接。

另外,人才是公司未来战略与业务实现的核心要素,公司积极引进技术及管理人才,优化人才结构,加强人才梯队建设,继续完善绩效考核评价体系及员工长效激励机制,目前已经在国内、北美、日本、韩国和欧洲等多地设立了研发中心,组建了拥有基础材料、基础技术、射频通信等领域深度研究经验和国际化视野的人才团队。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

公司始终专注于射频主业,不断深耕细作,通过多年与客户建立的良好合作关系以及持续的新业务拓展,实现了公司的可持续发展。本次募投项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的发展前景和经济效益。本次募投项目实施完成后,公司能够进一步用以提升技术水平及生产效率,巩固和提高公司的行业地位,并将进一步提升公司的核心竞争力。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后,公司的财务状况将得到进一步改善,公司总资产及净资产规模将相应增加,公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到提升。由于募集资金投资项目短期内不会产生效益,本次发行可能导致公司短期内净资产收益率下降,每股收益摊薄。但随着募集资金投资项目的建成投产,公司的盈利能力将得到明显提高。本次发行完成后,上市公司将获得大额募集资金的现金流入,筹资活动现金流入将大幅增加。未来随着募集资金拟投资项目的逐步建成和投产,公司主营业务收入规模将有大幅增加,盈利水平将得以提高。

四、可行性分析结论

经审慎分析，公司董事会认为，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合相关政策和法律法规，符合国家产业政策以及公司整体战略发展规划方向，具有实施的必要性。本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，增强公司综合实力与核心竞争力，有利于公司的长远可持续发展，符合全体股东的根本利益。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

2026年3月13日